BOMIN

博敏电子股份有限公司

BOMIN ELECTRONICS CO., LTD.

一图读懂

博敏电子

/股票代码：603936

2023年半年报

创新连接，沟通世界

经营业绩环比改善
盈利能力持续修复

- 报告期内，受经济复苏乏力和景气度下行影响，公司营业收入同比小幅下降1.39%，但二季度经营情况环比一季度呈现向好趋势，二季度营收环比增长30.79%。

营业收入	经营活动现金流净额
15.13 亿元	**2.05** 亿元

归母净利润	扣非归母净利润
7206.31 万元	**6029.38** 万元

归属上市公司股东净资产

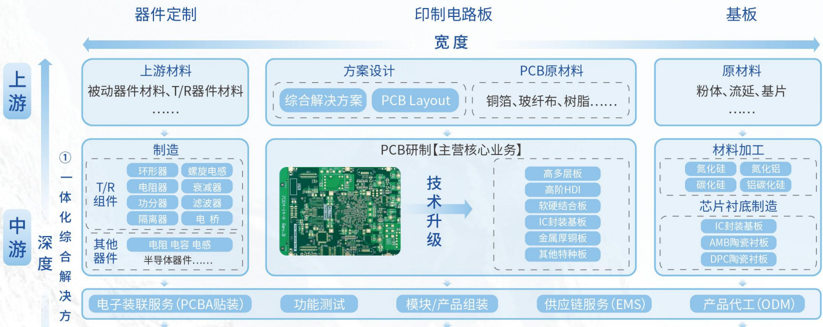
52.21 亿元

总资产

84.36 亿元

业务以PCB为内核延伸至PCB+多元业务打造博敏护城河

- 以 PCB 为内核横纵延伸至PCB+，持续加大定制化电子器件、模块化产品、微芯器件等高附加值产品的研发与开拓力度，形成了“主营业务+创新业务”的模式。



器件定制　印制电路板　基板

宽度

上游

上游材料
被动器件材料、T/R器件材料
……

方案设计
综合解决方案　PCB Layout

PCB原材料
铜箔、玻纤布、树脂……

原材料
粉体、流延、基片
……

中游

深度

① 一体化综合解决方

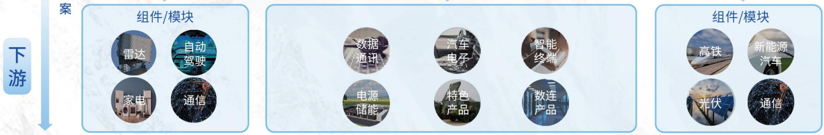
制造
T/R组件：环形器　螺旋电感　电阻器　衰减器　功分器　滤波器　隔离器　电 桥
其他器件：电阻 电容 电感　半导体器件……

PCB研制【主营核心业务】
技术升级
高多层板
高阶HDI
软硬结合板
IC封装基板
金属厚铜板
其他特种板

材料加工
氮化硅　氮化铝　碳化硅　铝碳化硅

芯片衬底制造
IC封装基板
AMB陶瓷衬板
DPC陶瓷衬板

电子装联服务（PCBA贴装）　功能测试　模块/产品组装　供应链服务（EMS）　产品代工（ODM）

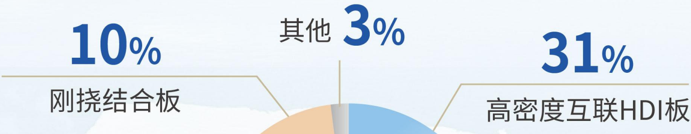


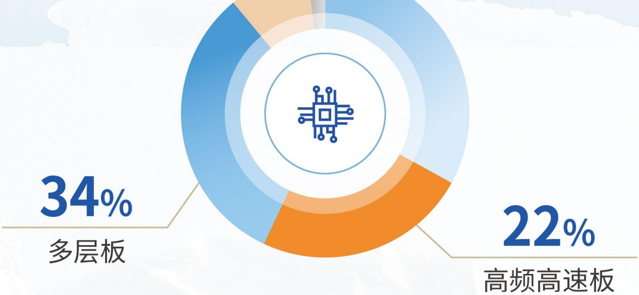
[蓝色部分为博敏业务领域]

坚持技术创新、产品高端化
战略聚焦四大核心赛道

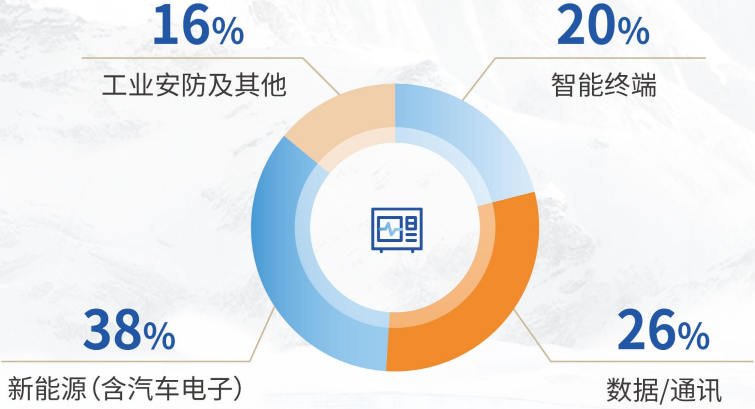
- 新能源营收比重近四成，成功中标国内头部与海外客户储能订单，保障稳定的订单来源，且订单份额有望继续攀升。

主要产品





产品应用



紧抓国产替代机遇

客户拓展稳步推进

- 客户资源丰富保持良好合作，客户粘性和数量逐年提升。

主营业务重点客户

屡获多个战略客户颁发的“最佳合作伙伴”
“最佳供应商”“金牌供应商”

BYD
HUAWEI
MERRY
广汽集团 GAC GROUP

Innovation WE DESIRE WE EXPLORE
SAMSUNG
FOXCONN 富士康
Great Wall 长城
OSRAM

WINGTECH PROFESSIONAL SOLUTIONS 闻泰科技
MOBIS 摩比斯
ZTE中兴
日海物联 SUNSEA IoT
Goertek

Hisense
amazon
Lenovo
TIANMA
JABIL

利亚德 LEYARD
HUAQIN
科大讯飞 iFLYTEK
京东方 BOE

创新业务重点客户

从器件定制走向EMS全供应链，从家电延伸至军工、

新能源（汽车、电单车、储能）、功率半导体

战略合作助力发展
再融资增厚资本实力

合肥经开区管委会战略合作

20亿陶瓷衬板，预计产能30万张/月

30亿IC载板，预计年销售额25亿元

6月设立子公司合肥博睿智芯微电子，预计今年Q4开工建设。

募投项目加快推进建设

定增募投项目完成项目地基平整（完成率 98%）、厂房主体基建、宿舍楼（部分主体结构已封顶）和地下室一期基础工程建设等。

预计**2024年**底首期投产

一期项目达产新增PCB年产能

172万平方米

陶瓷衬板积极招投标
封装载板已进入量产

陶瓷衬板

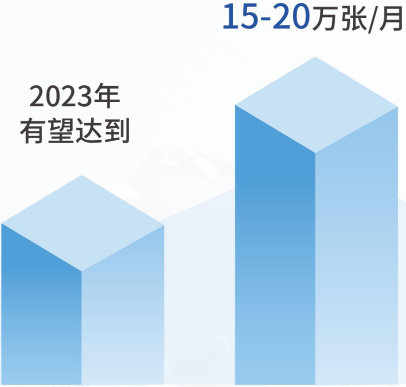
持续拓展新客户、积极参与客户招投标工作

通过多家客户认证、订单，预计下半年生产交付

第三代
半导体头部企业

海外车企
供应链客户

积极推动陶瓷衬板业务实现快速放量



IC载板

新增高端细线路

公司正式具备涉足

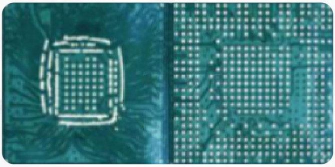
mSAP工艺封装载板

中高端IC封装载板能力

无芯板工艺
进入运营阶段

实现向FC类载板
技术转型

EMMC、MEMS、DRAM、Module等存储类产品已配合多家封测类客户进入小批量生产阶段，SD/microSD等产品送样认证中。



cxmt
长鑫存储技术有限公司
ChangXin Memory Technologies, Inc.

沛顿科技
Payton Technology

客户导入进程顺利，已为包括终端方案设计公司、封测公司在内

科大讯飞 IFLYTEK KONKA 康佳

的十多家客户进行打样试产，个别型号已进入量产阶段。

长按识别二维码查看财报原文

创新连接·沟通世界